

하나마이크론 WLP사업 본격화, 설비증설을 통한 외형성장

▶ 투자유치로 외형성장 달성..중장기적으로 최소 월 3만장의 Capacity 확충 계획

[2021-04-05]반도체 후공정 패키징 및 테스트 전문기업 하나마이크론(067310, 대표이사 이동철)에서 지난 1월 물적분할한 하나더블유엘에스(이하 하나WLS)가 본격 외형성장을 위한 설비증설을 추진한다고 5일 밝혔다.

하나WLS는 모회사인 하나마이크론의 BUMP(범프) 및 Probe TEST 사업부를 물적분할하여 설립된 회사이다. 2019년 범프 양산 개시 후 사업 안정화를 달성한 하나마이크론은 범프 사업을 강화하고 늘어나는 고객사 수주물량 대응을 위해 설비증설을 결정했다고 밝혔다. 하나WLS는 글로벌 자동차용 반도체 1위 기업 N社를 포함 국내외 팹리스(fabless)를 고객사로 두고 있다.

하나마이크론 관계자에 따르면 지난 3월 말 한국투자 파트너스와 노퍽캐피탈 컨소시엄을 통해 설비투자 자금 250억원을 유치했으며 추가 필요 자금은 내부유보금을 통해 조달 예정이라고 밝혔다.

이어 "이번 투자 유치를 통해 외형성장을 달성하고, 중장기적으로 최소 월 3만장의 Capacity 확충을 계획하고 있다"며 "회사는 2020년 110억원 수준의 매출을 기록했고, 5년이후 매출 1000억원 수준 달성을 기대하고 있다"고 덧붙였다.

하나WLS의 핵심 경쟁력은 RDL을 20 μ m 이상으로 구현하는 Thick RDL 기술로, 회사는 이를 개발, 양산할 수 있는 글로벌 유일 기업이다. Charger IC에 적용되며 반도체 칩 사이즈를 늘리지 않고도 고속 충전이 가능한 것이 강점이다.

실제로, 글로벌 기업 N사의 Quick Charger IC에 하나WLS의 Thick RDL 기술이 적용되어 삼성전자 스마트폰 플래그십 모델에 독점 공급되고있다. N사는 글로벌 자동차용 반도체 1위 업체로, 향후 자율주행차 및 전기차의 보편화에 따른 자동차용 반도체 수요 증가의 수혜를 받을 것으로 점쳐진다.

하나마이크론 관계자는 "하나WLS가 하나마이크론의 패키징 서비스와 연계를 통해 범핑부터 패키징, 최종 테스트까지 이어지는 후공정 Full Turnkey 방식의 경쟁사 대비 차별성 있는 사업모델을 제공할 것"이라며 "이로써 전통적 패키지 방식 뿐만 아니라 WLP, Flip chip, SIP, SOC 등 하이엔드(high-end) 패키지의 후공정을 모두 수행할 수 있게 된다"고 설명했다.



하나마이크론 이동철 대표이사는 “범핑 양산 개시 후 현재까지 적자를 이어오던 해당 사업이 올해 말 손익분기점을 넘어 내년부터는 이익면에서도 큰 폭의 성장을 기대한다”며 “이를 토대로 장기적으로는 12인치 범핑 사업 확대 및 FOWLP 기술개발 등 제품 다변화를 추진함으로써 사업의 효율을 높여 기업가치를 제고할 것”이라고 설명했다.

한편, 하나마이크론은 물적분할 이후 성장 보폭을 넓혀 향후 하나WLS의 기업공개를 추진할 방침이다.